

今年的考题大致也忘得差不多了，毕竟隔了这么长时间。回忆如下希望能有帮助。选择题很简单，认真看过书的同学相信都能很快完成。

以下是结合一些朋友的回忆我总结的今年题型的不同之处

- 1、固溶强化可以提高：A 屈服强度 B 抗拉强度 C 断裂强度
- 2、六方的坐标系和正交的坐标系换算，（临考前我特意看了换算公式的所以印象特别深）
- 3、两个刃型位错相交_____形成割接 A 一定能 B 不一定能 C 一定不能
- 4、下列是外延生长的是 a，二维 b，三维
- 5、下列致密度最高的是 a，Al b，Zn
- 6、再结晶后长大过程中 D 与 t 的关系（此种类型题目今年出了两个，当时考试的时候对比过）
- 7、三元相图中平衡反应有几相？
- 8、金属材料的颜色由什么光决定 A 反射光 B 折射光 C 吸收光
- 9、回复阶段主要影响？（*****是电导率，选项记不清了，有一个干扰项）
- 10、下列是热塑型材料的是 A.....

二，大题：

- 1，晶体结构 fcc 和 bcc，就是最简单的那种，画体心和面心的图和在网上画具体的晶面，晶向。
- 2，画铁碳（Fe-C）相图，写出平衡反应时的反应式（惟一个复杂一点的题，败在这个题上了）
- 3，扩散题，最基础那种，2004-2007 真题中的几乎一样，其中涉及扩散距离与时间的关系
- 4，位错只是加晶体学知识考核，（可以画图也可以纯计算，个人感觉画图简单些），就是告诉你位错类型和位错线方向然后求这个位错的各种参数和半原子面什么的，最后是写出分解成肖克利位错的反应式
- 5，说明金属，半导体，绝缘体的导电性差异的原因（十章内容，用价带理论解释那种题）